

证券代码：300757

证券简称：罗博特科

罗博特科智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-05

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒其他（电话会议）
-----------	---

	Management (Hong Kong) Limited、Schroders PLC、Schonfeld Strategic Advisors Llc
时间	2026 年 8 月 26 日 15:00-16:00
地点	公司 A 栋四楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 李良玉女士
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司 2026 年半年度业绩情况介绍 董事会秘书李良玉女士向各位参会方介绍了公司 2026 年半年度业绩相关情况： 营收方面，2026 年上半年，公司实现营业收入 60,848.01 万元，较上年同期增长 144.82%；实现归属于上市公司股东的净利润 655.68 万元，实现扭亏为盈。在光电子及半导体业务方面，公司实现营业收入 48,822.84 万元，占主营业务收入比重达到 81.16%，已成为公司核心业绩与增长驱动板块。公司在光电子半导体领域对可插拔光模块（含 NPO）、CPO、OCS 等多条技术路径实现全覆盖，可提供端到端的封装测试设备解决方案，同时，受益于 AI 产业链下游需求增长，订单实现较快增长，截至 2026 年半年度报告披露日，光电子业务尚未确认收入的在手订单金额约 24.52 亿元，创历史新高，为公司未来业绩持续增长提供坚实支撑；在光伏业务方面，受光伏行业系统性因素影响，营收规模持续承压，公司已将大量业务人员调配至光电子及半导体业务板块，完成资源优化配置。 毛利率方面，光电子及半导体业务板块毛利率为 42.91%，较上年同期合并财务报表口径下该业务板块的毛利率上升 8.14 个百分点；光伏业务板块毛利率为 32.62%，较上年同期上升 9.76 个百分点。光电子及半导体业务的毛利率提升主要来自批量化订单交付带来的规模效应、业务整合协同、国内基地产能持续爬坡等因素，毛利率提升态势有望在后续报告期延

续，直至到达相应的规模体量后保持较高的稳态区间水平。

费用方面，随着业务规模扩张及业务结构变化的影响，报告期的各项期间费用都有一定程度的上升。当然随着未来业务规模进一步扩大，期间费用有望得到摊薄，费率将逐步降低，利润率水平将随之逐步提升。

现金流方面，公司经营活动产生的现金流量净额为23,260.21万元，较上年同期实现大幅转正。公司抗风险能力和财务稳健性进一步增强，为公司长期可持续发展奠定了良好的基础。

公司2026年半年度报告的详细情况请各位参见公司2026年8月26日披露的《2026年半年度报告》。

以上是我对公司2026年半年度经营情况的整体介绍，感谢大家支持，欢迎提问交流。

二、问题交流

1、当前在手订单充裕，全年营收预测如何？

答复：公司目前的在手订单是构成本年度和未来年度收入确收的基础，此外，各技术路线均有不少项目在洽谈中，订单具备较强持续增长的基础。根据目前的项目排期来看，公司全年经营情况预计将维持持续向好的发展态势。2026年度经营业绩相关的具体情况请以后续公司披露的定期报告为准。

2、请问不同类型设备从订单到收入确认的转化周期如何？

答复：交付确收周期总体受设备类型、项目集中程度、工艺要求、上游供应链交期匹配状况等多方面因素的影响。如果仅考虑生产制造周期，通常情况组装类机型，纯制造周期约3-4个月，测试类设备制造周期相对更长，约6-9个月，如果是单面晶圆测试设备其制造周期会偏短一些。目前公司也在通

过各种举措持续优化缩短制造周期，提升生产效率。

3、请问公司目前对光伏业务和光电子业务的中长期定位是怎么样的？

答复：总体策略上，公司两大业务板块均采取了顺势而为的策略，尊重并顺应下游市场自身的发展态势调整相应业务规模。具体而言，在光伏业务方面，受行业调整周期影响，相比业务规模，公司更注重项目的质量，着重对新兴市场进行业务拓展，对优质项目积极争取，因此毛利率水平得到较好地保障，未来也将继续保持这一市场策略。光电子及半导体业务方面，2026 年半年度该业务板块占主营业务收入比重达 81.16%，已成为公司业绩的核心支撑和主营方向，重要性将持续提升。目前该板块得益于 AI 的驱动，光互联各技术路线多点齐发，需求侧均保持高速增长趋势，公司也将把握这一良好的市场发展机遇，加强业务拓展，持续提升产能满足下游客户需求，确保企业高质量发展。

4、请问公司产能规划及如何应对光电子业务订单的快速增长？

答复：公司总体将结合目前在手订单交期及下游客户未来订单的交期需求动态匹配公司的产能。量化来看，以苏州基地为例，公司认真评估过，通过各项资源要素的调配，仅苏州基地的产能预计未来就有能力达到每月生产约 300-400 台耦合及其他组装设备的产能规模，当然苏州也具备交付测试设备系列的能力。

公司已在台湾地区导入合作伙伴，后续将助力承担部分特定测试设备的产能需求，使德国及爱沙尼亚基地产能得以释放、专注其他测试产品系列。同时，苏州基地已新增部分零部件制造能力，可向多制造基地供货，进一步支持各基地产能释

放。此外，公司计划在港股 IPO 完成后于亚洲地区新建制造基地以进一步补充产能，港股 IPO 融资也将为产能扩张提供资源支持。

5、公司能为哪些光互联技术路径提供设备？如何看待 NPO 技术路径的未来发展前景及该技术路线对设备端口的要求有哪些变化？

答复：ficonTEC 不仅可以适配传统可插拔光器件技术路径，也可以适配硅光、NPO、CPO、OCS、OIO 等前沿技术方向，实现全技术路径覆盖。因此公司能够灵活响应不同客户在不同技术演进阶段的需求。其中，NPO 作为可插拔与 CPO 之间的过渡技术路径，目前也是部分下游客户未来的技术路径选择方向，公司及子公司在该技术路径方面同样具备设备供应能力。目前，公司的在谈项目中也包含 NPO 方向的项目在持续推进中。未来如果相关进程达到披露的标准，公司亦将依据相应规则及时履行披露义务。

NPO 技术路径对设备的要求比较类似可插拔方案，因此在我们内部也将其归类到可插拔的大类，但其设计相较而言集成度有所提高，因此对设备的要求也有一定程度的提升。

6、公司在 CPO 测试环节可以提供的 INS2/3/4 设备竞争地位以及未来市场需求量级如何？

答复：从核心客户给出的具体、明确的需求预测来看，下游市场对 CPO 的高速增长需求清晰可见，客户订单和交货时间压力持续加强，CPO 产业化正处于全面加速推进进程中。

在 CPO 测试环节，公司在 Insertion2 和 Insertion3 占据特殊的市场地位，已为核心客户提供批量化量产设备，并将按照其需求节奏的要求，持续为核心客户提供后续不断增加的量产设备，系 CPO 技术的商业化进程在测试设备端的核心支撑方。

	Insertion4 目前处在公司配核心客户 NPI 的进程中，公司正在按照客户的需求加快推进该系统级测试设备的开发进程，相关进展请关注公司后续的相关公告。 7、港股 IPO 进展如何？ 答复：公司相关 H 股发行工作正在有序推进中，公司已于 6 月底前取得中国证监会出具的境外发行上市备案通知书，目前处于联交所的审核阶段。由于我们是一个 A to H 的项目，A 股披露中报，意味着我们必须要向联交所补报半年报审阅等材料，目前公司会同中介机构正在全力以赴准备相关申报材料积极配合联交所审核端需求，力求尽快完成港股上市。公司将严格按照有关规定及时披露后续进展情况，敬请关注公司后续发布的相关公告。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 8 月 26 日